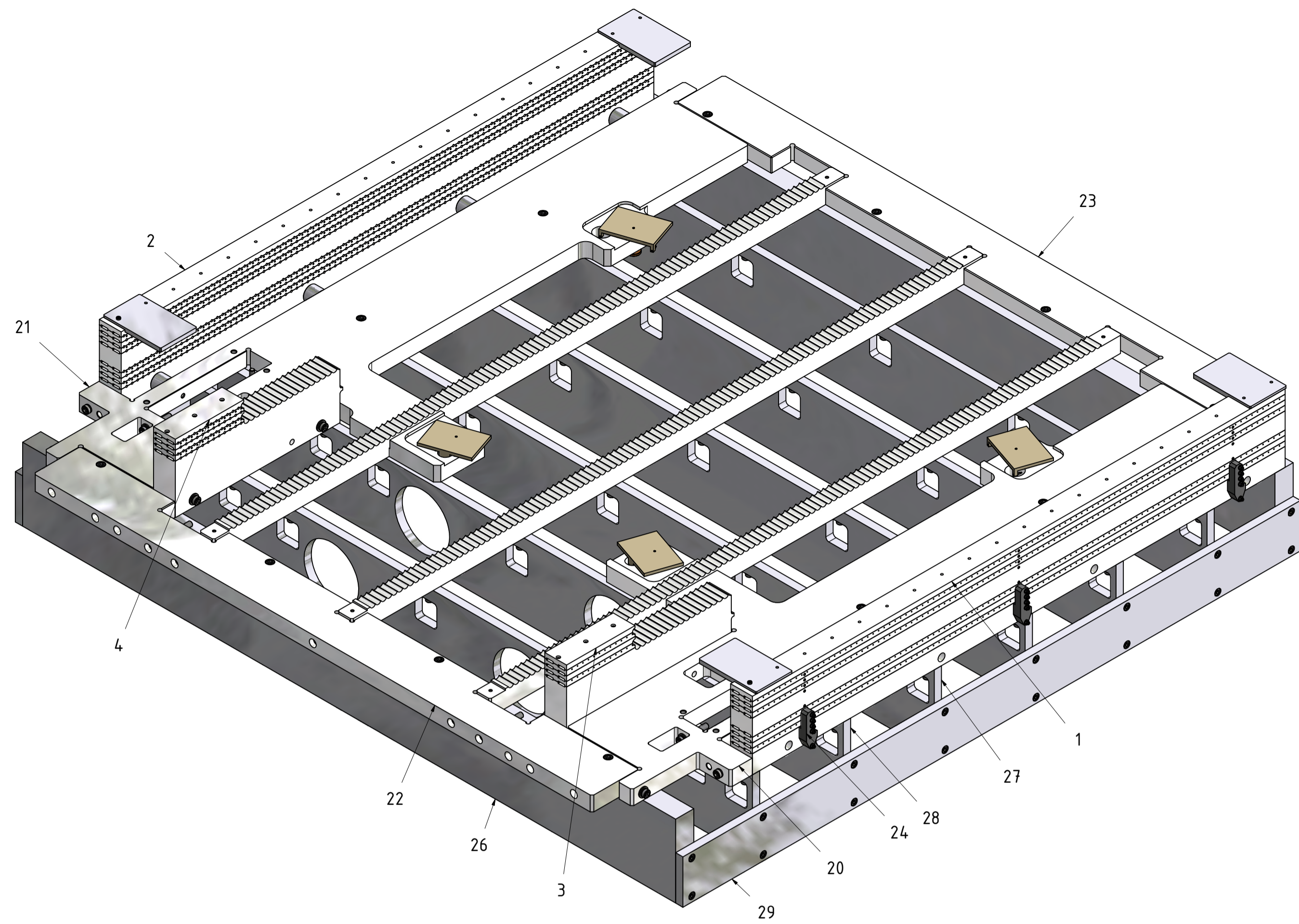
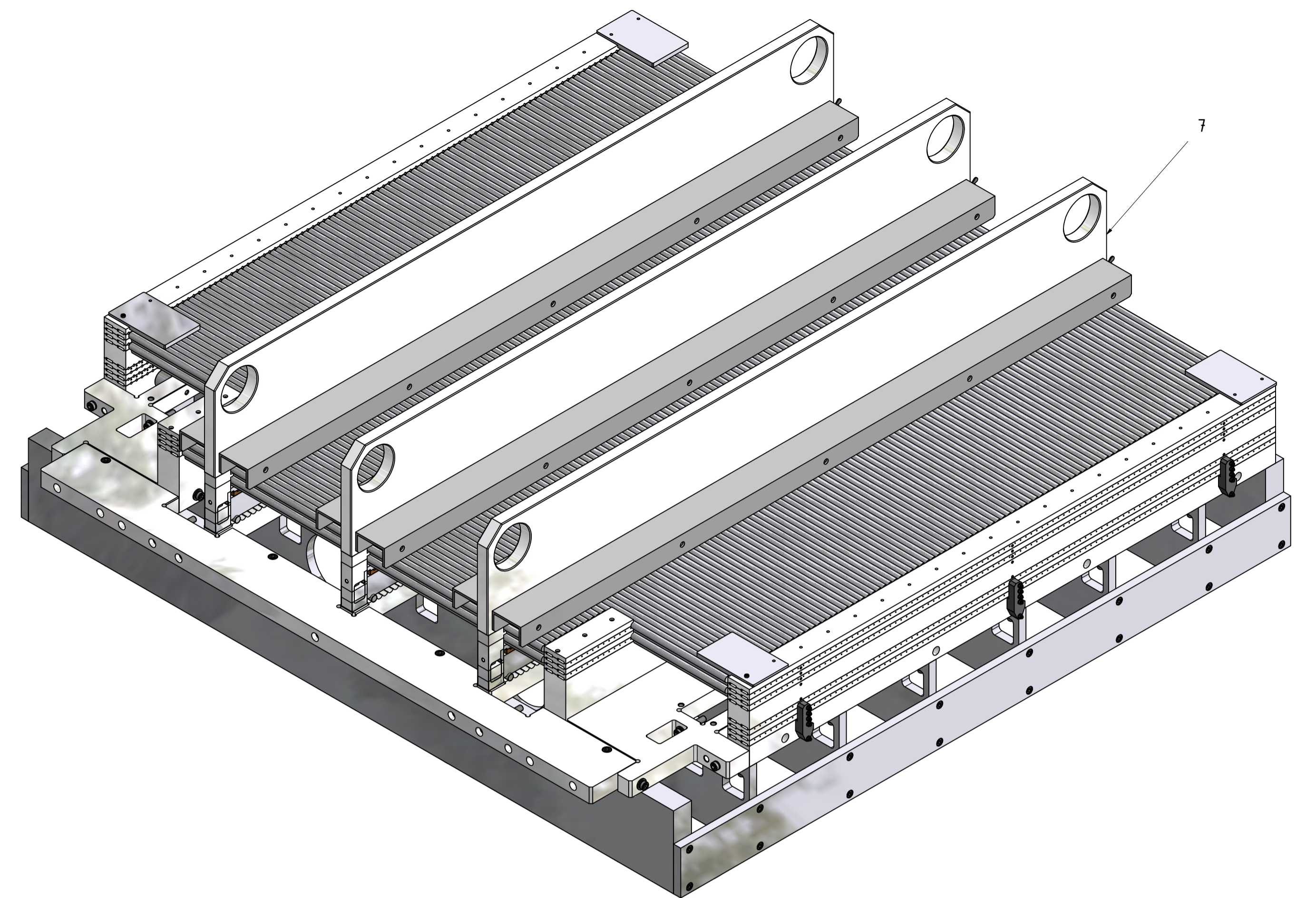


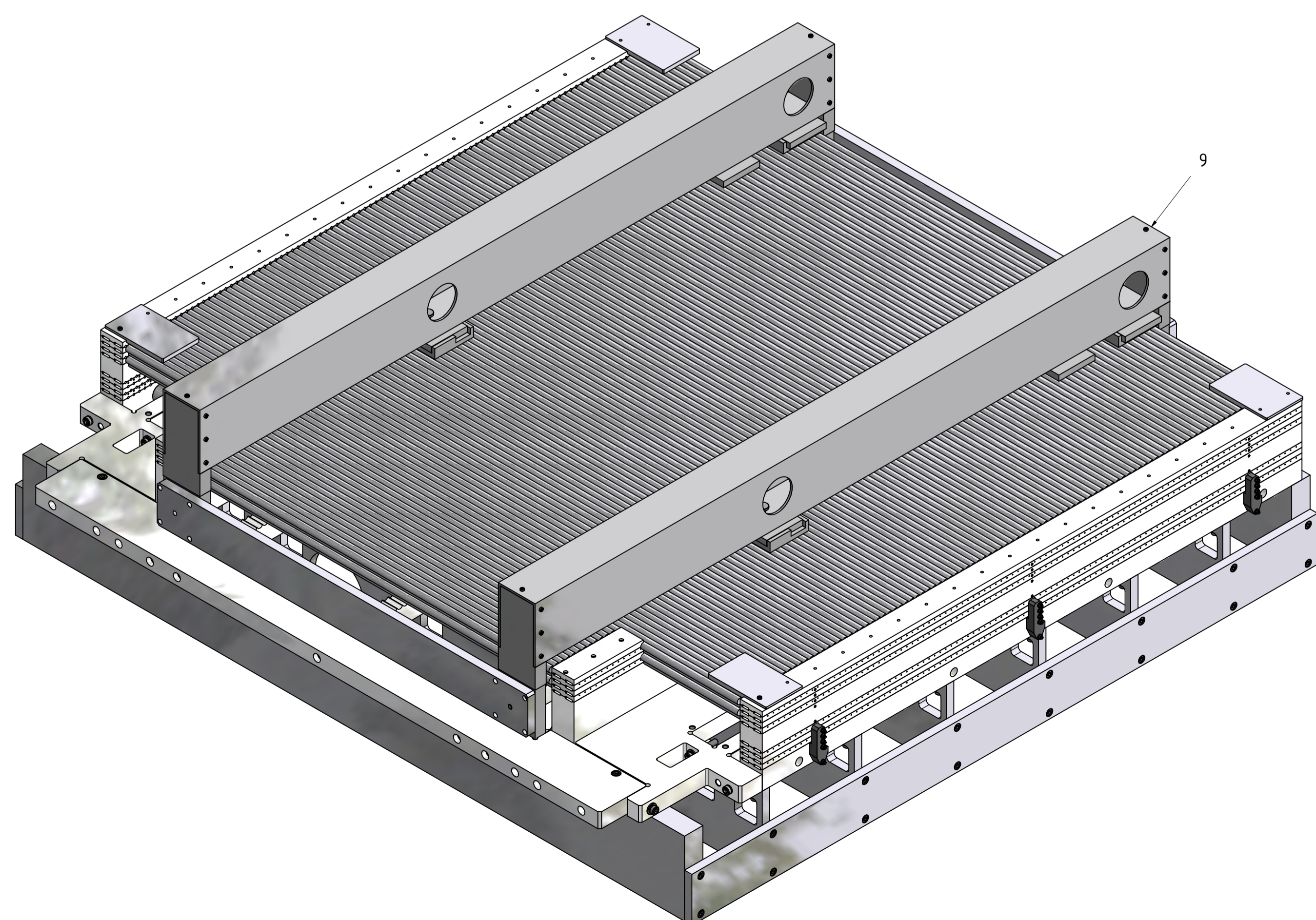
1. BIS-NSW platforms gluing.



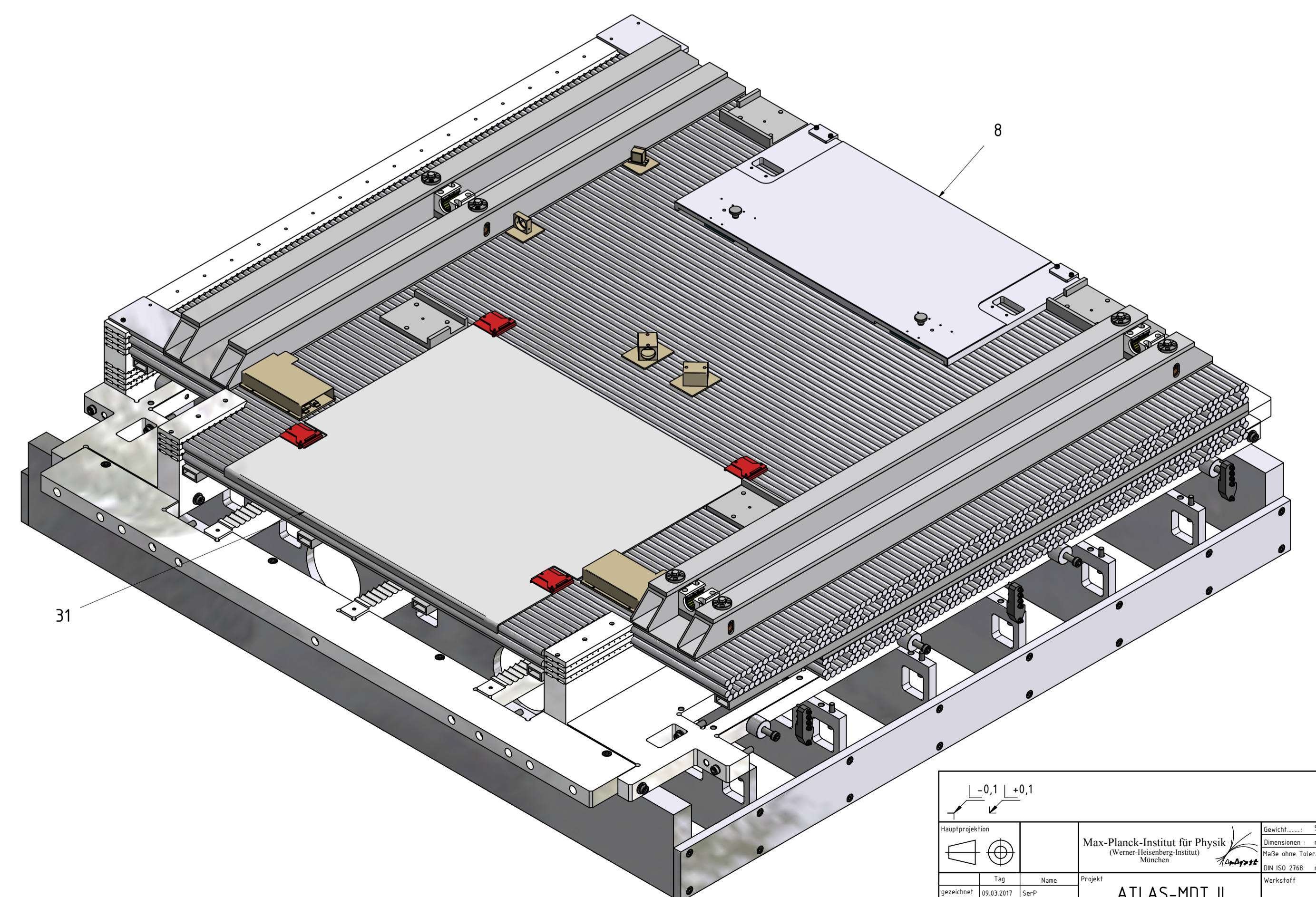
2. MULTILAYER and SPACER gluing.



3. AXIAL-PRAXIAL platforms gluing.



4. SUPPORTS, CCC platforms, B-field platforms, IN-PLANE alignment components gluing.



		Max-Planck-Institut für Physik (Werner-Heisenberg-Institut) München		Gewicht: 5785,284 kg Dimensionen: mm Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768
Tag: 09.03.2017 gezeichnet: Sarp bearbeitet: gezeichnet:	Name: Sarp	Projekt: ATLAS-MDT II BIS-78	Werkstoff:	Zeichnungsnummer / EDW Nr.: 104-212000-00.idw Software: Inventor 2016 Blatt: 2 / Gesamtzahl: 2 DWG: EN 2D 216 - A3 (A4 x 2)
Maßstab: 1:5 1:1	BIS-78 ASSEMBLY JIG		Zeichnungsnummer / EDW Nr.: 104-212000-00.idw Software: Inventor 2016 Blatt: 2 / Gesamtzahl: 2 DWG: EN 2D 216 - A3 (A4 x 2)	Teil: